汀苏微导纳米科技股份有限公司

江				
投资者关系活动记录表				
投资者关系活动类别	■特定对象调研	□分析师会议		
	□媒体采访	■业绩说明会		
	□新闻发布会	■路演活动		
	■现场参观	■电话会议		
	□其他 (<u>请文字说明其他活动内容</u>)			
	中国国际金融股份有限么	公司、中国对外经济贸易信托有限公司、		
	上海证券有限责任公司、	深圳前海博普资产管理有限公司、北京		
	市星石投资管理有限公司、招商信诺人寿保险有限公司、中欧基			
	金管理有限公司、天风证券股份有限公司、圆信永丰基金管			
	限公司、Ginkgo Tree Asset Management Pte. Ltd、Korea Investm			
	Corporation Nomura Asset Management Pictet Asset Managem			
	Limited , Goldman Sach	ns (Asia) LLC Wexford Capital LP		
	Mackenzie Investments Asia Limited , TD Asset Management ,			
参与单位名称	Amitell Capital Pte. Lt	td. , Helved Capital , Ovata Capital		
	Management , STELLAR JAMES MANAGEMENT Pte Ltd ,			
	Fidelity Management & Research Allianz Global Investors Asia			
	China Investment Corp、I	Davidson Kempner Schroders Investment		
	Management, UBS Group	oAG、泰康资产管理(香港)有限公司、		

Millennium Management, Pinpoint Asset Management, Point 72 Asset Management, Polymer Capital Management, Nikko Asset Management、Janchor Partners、统一证券投资信托股份有限公司、 Anatole Investment Management CloudAlpha Capital Management Limited, Optimas Capital, Stoneylake Asset Management (Hong Kong) Limited、嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司、 西部证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、长江养老保险 股份有限公司、广州正圆投资管理有限公司、华创证券有限责任

	公司、宝盈基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、中信保			
	诚基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、华商基金管理有			
	限公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国			
	人民保险集团股份有限公	诺资产管理有限公司、通过		
	"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与微导纳米"2025 无锡上市公司投资者集体接待日活动暨 2025 年第三季度业绩说明会"的			
	广大投资者			
公司接待人 员姓名	总经理周仁、董事会秘书龙文、财务总监俞潇莹、证券事务代表			
	朱敏晓、证券部王少峰			
日期/时间	2025年10月31日-2025年11月4日	地点	公司会议室、"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net)	
	一、公司简介			
	微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装			

微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以原子层沉积(ALD)技术为核心,化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系,专注于先进微米级、纳米级薄膜设备的研发、生产与销售,向下游半导体、泛半导体客户提供尖端薄膜设备、配套产品及服务。

投资者关系 活动主要内 容介绍

原子层沉积(ALD)等尖端薄膜沉积技术作为原子级制造的核心关键技术之一,凭借优良的技术特性,具有广泛的普适性,在半导体集成电路、新能源、新材料等领域均有着重要的应用前景。微导纳米相关产品已在半导体、光伏领域实现了大规模产业化应用。

在半导体领域内,公司是国内首家成功将量产型 High-k 原子层沉积设备(ALD)应用于集成电路制造前道生产线的国产设备厂商,是国内首批成功开发并进入产业链核心厂商量产线的硬掩膜化学气相沉积设备(CVD)国产厂商,也是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一。目前公司已与国内多家厂商建立了深度合作关系,相关产品涵盖了逻辑、存储、先进封装、化合物半导体、新型显示(硅基 OLED等)等诸

多细分应用领域,多项设备关键指标达到国际先进水平,能够满足国内客户当前技术的需求以及未来技术更迭的需要。

在光伏领域内,公司作为率先将 ALD 技术规模化应用于国内光伏电池生产的企业,已成为行业内提供高效电池技术与设备的领军者之一,与国内头部光伏厂商形成了长期合作伙伴关系。同时,公司跟随下游厂商的量产节奏,持续优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电池等新一代高效电池技术,引领光伏行业技术迭代。根据公开的市场数据统计,公司 ALD 产品已连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一。

2025 年 1-9 月,公司实现营业收入 17.22 亿元,同比增长 11.48%;实现归属于上市公司股东的净利润 24,849.52 万元,同 比增长 64.83%。其中,受益于国产存储芯片产能的持续扩充,以及逻辑、先进封装等领域设备国产化率的提升,公司半导体业务持续放量,订单和收入均实现了快速增长。2025 年 1-9 月,公司半导体设备营业收入 5.26 亿元,同比增长 78.27%,占营业收入的比例达到 30.56%;半导体领域新增订单约 14.83 亿元,同比增长 97.26%。

二、主要交流问题及回复

1、能否简要介绍一下公司,并谈谈公司在全球薄膜沉积设备领域处于什么位置?

微导纳米成立于 2015 年,由 LI WEI MIN 博士等半导体薄膜沉积技术专家共同创立,初心是将 ALD 等尖端薄膜沉积技术产业化应用于国内半导体及泛半导体领域。伴随国内半导体产业自主创新与国产化的发展浪潮,公司实现了快速发展。

2019 年,公司成功研制了国内首台应用于集成电路制造前 道生产线的量产型 High-*k* ALD 设备并实现量产,解决了关键工 艺的"卡脖子"问题。此后,公司又持续推出多款 ALD 和 CVD 产 品,在多个关键工艺领域实现了国产化的突破,应用领域覆盖了

逻辑芯片、存储芯片、先进封装、化合物半导体和新型显示(硅基 OLED)等领域。通过多年的自主创新和技术积累,公司多项核心设备的关键性能指标达到国际先进水平,产品与国际龙头厂商相竞争。

2、公司核心技术(如 ALD 技术)的护城河,或者说不可替代性主要体现在哪些方面?是否容易被复制?

半导体薄膜沉积设备的研发和制造是一个需要长期经验积 累的行业,其技术涉及材料、机械、软件等多个学科,行业壁垒 极高。

公司创始团队及核心管理人员均来自国内外顶尖半导体设备企业,具有超过30年的丰富研发与运营管理经验。在此基础上,公司建立起一支涵盖电气、工艺、机械、软件等多领域的专业工程师队伍,形成跨学科、多层次的人才梯队,是国内相关领域中人才体系最完整、投入最多、规模最大的专业团队之一。

基于上述基础,公司产品才能如此之快的脱颖而出,在产业 化程度、工艺覆盖度、技术领先程度和下游客户的合作等多个方 面处于国内第一梯队,在国内半导体产业国产化过程中扮演着 重要角色,核心技术难以被简单复制。

3、如何看待目前人工智能(AI)技术对未来半导体产业, 尤其是国内半导体设备产业的影响?

人工智能 (AI) 技术的迅猛发展,正日益成为驱动半导体产业创新与变革的重要引擎。一方面,伴随 AI 算力需求的持续提升,先进芯片产能的扩张,为半导体设备市场带来了强劲且持续的增长动力;另一方面,AI 应用的广泛落地也不断推动先进制程与芯片架构的演进,对制造工艺提出了更高、更复杂的要求。

AI 技术的发展倾向于更先进的制程、更复杂的结构和先进 封装,这恰恰是 ALD 等尖端薄膜沉积技术能够充分发挥优势的 应用领域。ALD 技术具有优异的三维共形性、大面积均匀成膜 能力以及精准的膜厚控制,这些特点使 ALD 技术非常适用于超 薄薄膜、超小线宽以及复杂形貌结构的芯片制造,契合了当前的发展方向,因此需求日益旺盛。

总体来看,AI 技术正深刻影响半导体产业的技术路径与竞争格局。具备自主创新能力与核心技术积累的国内半导体设备企业,将能更好地响应下游客户对新工艺的需求,从而在行业变革中把握机遇,提升整体竞争力。

4、公司如何在半导体设备国产替代浪潮中把握机会?未来 几年公司业务的主要驱动力来源于哪里?

一方面,国产化趋势持续推进中,国内晶圆厂商对半导体工艺设备的国产化需求强烈,本土半导体设备的导入和验证加速,国产半导体设备市场前景良好。另一方面,目前整体国产化率仍处于较低水平,尤其在薄膜沉积等核心设备领域,中高端产品的国产化进程明显滞后,相关产品的需求尤为紧迫。

得益于公司在关键工艺领域的技术突破,以及下游客户对公司产品认可度的持续提升,过去几年公司半导体的订单、收入都实现了高速增长。未来随着国内半导体产业技术迭代对高端半导体薄膜沉积设备需求增加,以及公司研发产品种类和工艺覆盖面不断提升,量产规模不断增加,预计公司半导体业务将持续保持增长态势。

5、公司半导体新增订单大部分来自于 NAND 和 DRAM 领域的头部客户,ALD 技术在半导体存储领域内的前景如何?

ALD 技术在 DRAM、3D NAND 和新型存储等方面均有十分良好的应用前景。DRAM 领域内,随着存储器容量不断增大,其内部的电容器数量随之剧增,而单个电容器的尺寸将进一步减小,器件内部沟槽以及深孔的深宽比也越来越大,因此对具备高均匀性、高台阶覆盖率和对膜厚的精确控制的 ALD 技术需求越来越大。NAND 领域,随着 3D 结构内部层数不断增高,元器件逐步呈现高密度、高深宽比结构,ALD 可以实现高深宽比特征下的均匀镀膜,其应用随着层数的增加而不断的增大。

6、公司订单一直保持高速增长,无疑证明了公司的市场认可度。后续公司如何保证产能的稳定性和交付能力?是否有原材料涨价风险?

公司一直秉承着"专注、极致、口碑、快"的企业文化,使微导纳米能快速响应客户需求,建立了良好的市场口碑。为抓住市场机遇,巩固竞争优势,公司正积极推进半导体业务相关项目的建设进度,提升公司薄膜沉积设备的生产能力、研发能力及科技成果转化能力。

目前来看,原材料供应及价格风险整体可控。整个上游零部件和原材料行业也在快速发展和技术迭代,会很快实现技术与产能的匹配,达到市场供需的平衡。

7、为何同行业公司,如先导三季度是暴增?而且贵司中报 也讲三季度订单暴增,但利润暴跌?是为了 12 月的解禁深蹲 吗?

尊敬的投资者您好。2025 年 1-9 月公司半导体领域新增订单约 14.83 亿元,同比增长 97.26%。公司设备从发货到完成验收确认收入需要一定周期。目前,公司半导体业务在手订单充足,为公司未来半导体业务发展奠定了坚实基础。感谢您的关注。

8、公司在 ALD 技术方面竞争优势如何?

尊敬的投资者,您好!公司是国内领先的 ALD 设备供应商,相关产品涵盖了行业所需主流 ALD 薄膜材料及工艺。ALD 技术在 45nm 以下节点以及 3D 结构等先进半导体薄膜沉积环节具有良好的应用前景,是半导体设备中增长最快的领域之一。公司开发的国内首台成功应用于集成电路制造前道生产线的量产型 High-k ALD 设备,解决了国内集成电路突破 28nm 制程节点最核心工艺之一的高介电常数 (High-k) 栅氧层薄膜工艺。公司持续拓展技术覆盖面,陆续研发和推出 HKMG 技术、柱状电容器、金属化薄膜沉积技术及高深宽比 3D NAND、3D DRAM、TSV 技

术等工艺解决方案,覆盖逻辑芯片、存储芯片、先进封装、化合物半导体和新型显示(硅基 OLED)中 ALD 技术的主要应用场景。感谢您的关注。

9、你好,现在半导体业务收入占总收入的比例是多少?

尊敬的投资者您好。2025 年 1-9 月,公司半导体设备营业收入 5.26 亿元,同比增长 78.27%,占营业收入的比例达到 30.56%。感谢您的关注。

10、公司主要客户有哪几个? 近期有大合同签约和扩大新生产线的动作吗?

尊敬的投资者,您好! 2025 年度公司半导体领域的新增订 单主要来源于 NAND 和 DRAM 领域的头部客户。随着客户扩产 节奏和工艺开发进度的加速,公司将持续扩大核心产品的产能 并推进新产品的研发,相关工艺技术对推动存储芯片技术迭代 尤其是 3D DRAM、3D NAND 技术的研发与产业化具有关键支 撑作用。展望未来,在 3D 结构层数持续增加及客户产能规模加 速扩张的背景下,相关设备需求有望持续放量,业务将保持增长 态势。感谢您的关注。

11、公司现有半导体设备在手订单金额是多少?

尊敬的投资者,您好!公司 2025 年 1-9 月半导体领域新增订单约 14.83 亿元,同比增长 97.26%。感谢您的关注。

12、公司的产品在先进封装领域是否已经有在手订单?

尊敬的投资者,您好!先进封装技术是提升芯片性能与集成 度的关键路径,市场前景广阔。公司作为国内少数具备该领域设 备研发与生产能力的企业之一,在先进封装领域已建立起先发 优势。目前,公司相关设备已在客户端进行验证,并与多家潜在 客户开展技术交流。感谢您的关注!

13、能介绍一下公司三季度光伏产品设备收入减少的具体原因吗?

尊敬的投资者,您好!公司光伏客户以行业内大型厂商为

主,客户扩产投资并采购公司设备存在非均匀、非连续的特征,导致公司各季度间的验收情况存在差异。因此,公司营业收入在各季度间存在一定波动,不存在稳定的季节性特征。感谢您的关注。

14、请问公司在半导体薄膜沉积设备领域相较拓荆科技,哪 些产品领域拥有相对优势?

尊敬的投资者,您好!作为国内半导体薄膜沉积设备领域的 技术引领者之一,公司紧抓下游产业链核心客户产能扩张和技 术创新机遇,加大研发投入和市场拓展力度,持续加快了新产品 和新工艺的推广。ALD设备已涵盖了行业所需主流 ALD薄膜材 料及工艺,在高介电常数材料、金属化合物薄膜等领域均实现了 产业化应用,量产规模不断增加。CVD设备在硬掩膜等关键工 艺领域已实现产业化突破,进入存储芯片等领域先进器件量产 生产线,并持续推出客户所需的多款关键工艺设备。感谢您的关 注!

15、公司中报,只公布了半导体设备订单,请问公司全部是订单有多少?

尊敬的投资者您好,相关信息请以公司公开披露内容为准。感谢您的关注!

16、新凯来与公司是否有何合作?新凯来的薄膜沉积设备进展对公司的国内市场影响如何?

尊敬的投资者您好。公司始终致力于与所有客户和友商保持良好的合作关系,共同助力国内半导体产业的发展。目前来看,高端薄膜沉积设备的国产化率相对较低,市场空间巨大,在中国半导体产业发展的重要战略时期,需要多家优秀的半导体设备公司,为产业的发展做出贡献,充分发挥各自的比较优势,共同推动半导体设备的良性竞争与发展。感谢您的关注。

17、公司光伏设备领域新签订单情况如何?现阶段光伏设备行业景气度如何?

尊敬的投资者您好。光伏行业装机需求和产业规模仍保持增长,但受产业链各环节新增产能快速释放影响,短期内出现供过于求,产业链各环节盈利水平总体承压。近期,随着国家政策引导,下游光伏电池片厂商也正积极通过技术创新、成本控制等方式,推动行业向高质量发展转变。感谢您的关注!

18、后续贵司是否还有回购股份的计划?以提高中小投资者的信心

尊敬的投资者您好。公司 2024 年共实施两次股份回购计划, 回购金额已累计超亿元。若后续有相关计划,公司将严格按照相 关要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

19、三季度微导纳米半导体新增订单相较上半年增速下降, 请问具体原因是什么?

尊敬的投资者您好。公司客户扩产投资并采购公司设备存在非均匀、非连续的特征。未来,公司将紧跟下游半导体客户的扩产节奏以及对新产品、新工艺的动态需求,持续推动产品和技术创新。感谢您的关注。

20、请问中标的北京大学的和中科院的设备,是否都已经交付,结算完成

尊敬的投资者您好。公司始终致力于与所有客户保持良好的合作关系,按照签订的商业合同条款稳步推进合作,确保项目的顺利实施。感谢您的关注。

21、半导体薄膜沉积设备智能化工厂预计 2026 年几月份可以投产?国家大基金有没有调研过贵司,有没有预期进入大基金的支持名单?

尊敬的投资者,您好!公司半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目已经开始投资建设,规划的建设期为三年,公司将在规划的建设期内加速项目的落地,以确保能够及时满足客户对半导体设备的需求。公司的发展离不开社会各界的关注和支持。公司将严格按照上交所相关规定及时履行信息披露义务,相关情

况请以公司在上海证券交易所网站发布公告为准。感谢您的关 注。

22、三季报营收不降,净利爆降的原因是什么?未来经营情况咋样?

尊敬的投资者,您好!公司客户扩产投资并采购公司设备存在非均匀、非连续的特征。近年来,半导体设备国产化替代加速推进,公司将持续把握这一战略窗口期,紧密跟进下游产业链核心客户产能扩张和技术创新需求,加大研发投入和市场拓展力度,加速产品推广和验证。预计未来公司半导体收入、订单占比将继续保持稳步增长。感谢您的关注。

23、公司薄膜沉积设备是否应用于固态电池领域?

尊敬的投资者您好。公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商,专注于先进微米级、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产与销售,向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。同时,公司也一直致力于探索先进薄膜沉积技术在各新兴应用领域的发展机会。具体信息请以公司公开披露内容为准。感谢您的关注!

24、如何看待光伏反内卷,光伏今年新增订单情况以及新技术商用情况是怎样的?

尊敬的投资者您好。近期,随着国家政策引导,下游光伏电池片厂商也正积极通过技术创新、成本控制等方式,推动行业向高质量发展转变。行业加速整合与技术迭代,直接驱动了高端设备的需求,具备相应技术储备和研发实力的公司具有更强的市场竞争力。公司长期深耕光伏新能源产业,在 TOPCon、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等电池技术领域均有产品储备、布局和出货,为下游厂商提供全球领先的设备产品和解决方案,持续引领行业技术发展。感谢您的关注。

25、请问贵公司以后的研发重心将落在哪一块?研发人员 是否还会继续增加?国内市场与国外市场是否有扩大趋势?是 通过单个业务订单金额增长还是通过客户群体增加提升销售金额?

尊敬的投资者,您好!半导体领域,公司将聚焦半导体高端薄膜工艺和解决方案,持续推动半导体设备国产化进程服务并引领半导体新架构、新器件发展。光伏领域,公司将密切追踪全球光伏市场机遇,以"整线解决方案"为核心战略支点。公司会继续加大研发投入和市场拓展力度,一方面提升领域内深度,同时也会不断扩大客户群体。感谢您的关注。

26、今年公司在光伏设备领域订单情况如何?

尊敬的投资者,您好!近期随着国家政策引导,下游光伏电池片厂商也正积极通过技术创新、成本控制等方式,推动行业向高质量发展转变。具体信息请以公司公开披露内容为准。感谢您的关注!

27、周总您好,公司后续将从业绩兑现,股东回报(分红/回购),估值优化,信息披露哪些方面推进市值与价值匹配?智能工厂,2nm设备等关键节点有何配套举措?

尊敬的投资者您好,公司上市以来一直高度重视市值维护工作,关注公司的资本市场表现。未来公司将进一步通过聚焦主业、推动创新、规范公司治理、提升投资者回报以及增强投资者沟通等多种方式,进一步增强核心竞争力。市值管理是一个长期且多维度的任务,我们将不懈努力,通过上述措施以及可能的其他行动,来提升公司的市场表现和内在价值。感谢您的建议。

风险提示

- 1、以上如涉及对行业的预测、公司发展战略等相关内容,不能 视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证,敬请广 大投资者注意投资风险。
- 2、电话会议参会名单由会议组织方提供。

关于本次活 动是否涉及 应当披露重 大信息的说 明

不涉及